

# 关于江苏苏州德信芯片科技有限公司 110 千伏配套工程的公示

## 一、项目概况

德信芯片地块位于金光产业园，前戴路南、惠浦路西，因地块 110 千伏电力的接驳需求，需从金光产业园 220 千伏兴浦变规划新建一根 32 通 110 千伏电力通道，沿胜浦路道路中分带由北往南接驳至地块西侧新建分支站。建设内容包括新建电缆分支站一座，规划建设 110 千伏电力管线总长约 360 米。



本项目位置示意图

## 二、公示期限

自公示发布之日起 10 天。

## 三、意见反馈单位

1.单位名称：苏州工业园区高端制造与国际贸易区管理委员会

联系人：徐工 电话：0512-62586936

2.单位名称：苏州诚诺咨询管理有限公司

联系人：顾工 电话：0512-68732872 邮箱：SZCN0703@163.com

## 四、公众参与方式

为保障公众知情权，广泛听取和收集各利益相关群体对该项目的意见，公众如对本项目有任何问题、意见和建议，均可在公示期内通过电话、邮件等形式与意见反馈单位联系。

苏州工业园区高端制造与国际贸易区管理委员会

2026年3月13日

